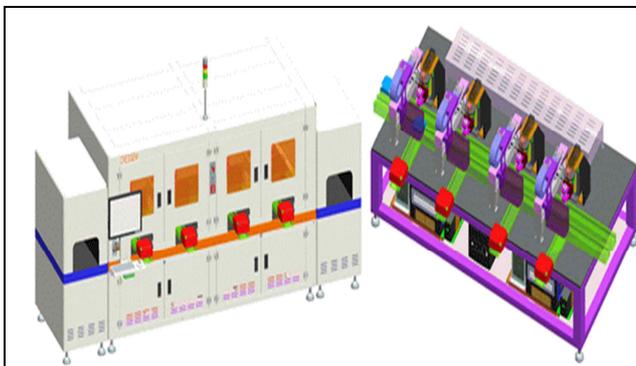


(주)크레셈

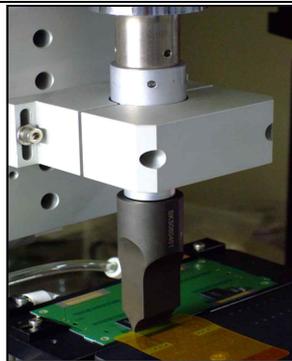
개 요	회사명	(주)크레셈	설립일	2014.06.02
	대표이사	오상민	소재지	대전시 유성구 문지로
	자본금	500백만원	업종	ACF 본딩장비 제조
기 술	학교	한국과학기술원(KAIST)	개발자(소속)	백경욱 교수(신소재 공학과)
	기술완성단계	시제품 제작 및 평가	참여형태	기술이전
파 트 너 사	회사명	(주)미르기술	사업분야	SMT 검사장비, LED package 장비등

사업 개요

기술 요약	<ul style="list-style-type: none"> • 초음파 ACF 접합 기술 - 열압착 방식(기존): 외부에서 열원을 통한 에너지 공급으로 ACF 필름의 경화 유도 - 초음파 ACF 접합: 외부의 열 가열 없이 초음파 진동에 의하여 ACF film이 자체 발열하면서 경화 발생(백경욱 교수)
시장 현황	<ul style="list-style-type: none"> • ACF는 현재 스마트카드, 액정표시장치, 디스플레이패널, 컴퓨터, 휴대용 전화기기 및 통신시스템 등 여러 전자부품에 폭넓게 사용 - ACF 세계 시장 규모는 1조, ACF 접합장비는 5,500억원으로 추정(2015년 기준) • 대형 TV 및 노트북, 게임기등 중소형 제품의 수요 증가 및 성장이 예상됨에 따라 향후 ACF 접합장비 시장도 지속적 확대 예상
사업화 계획	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계('15년) 세미오토급 접합장비 개발 및 대면적 접합가능 혼 개발 • 2단계('17년) In-Line용 자동화 접합 장비 개발 및 상용화(FOB, FOG 방식) <ul style="list-style-type: none"> - 독자 영업/마케팅 네트워크 구축 - 별도 생산 시설 구축 및 제조 인력 확보 • 3단계('19년) Module 타입 양산 자동화 장비 개발 및 상용화(COB, COG방식)



<초음파 ACF 본딩 장비 이미지 >



<접합 부분 사진 >



<컨트롤러(초음파신호생성)>